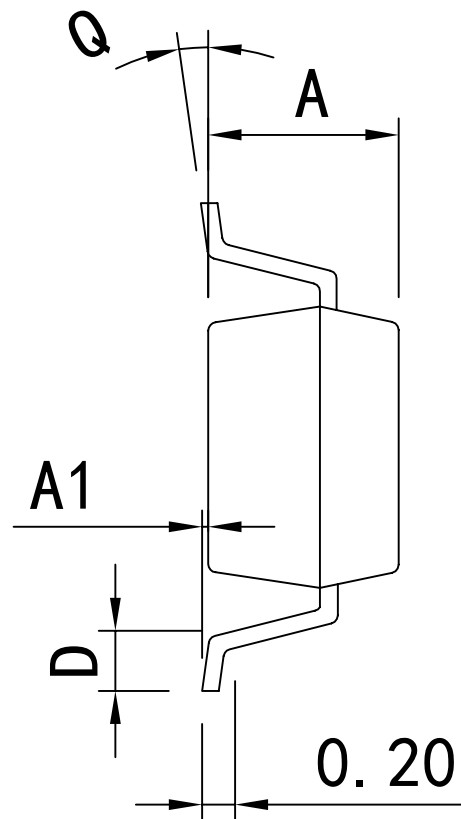
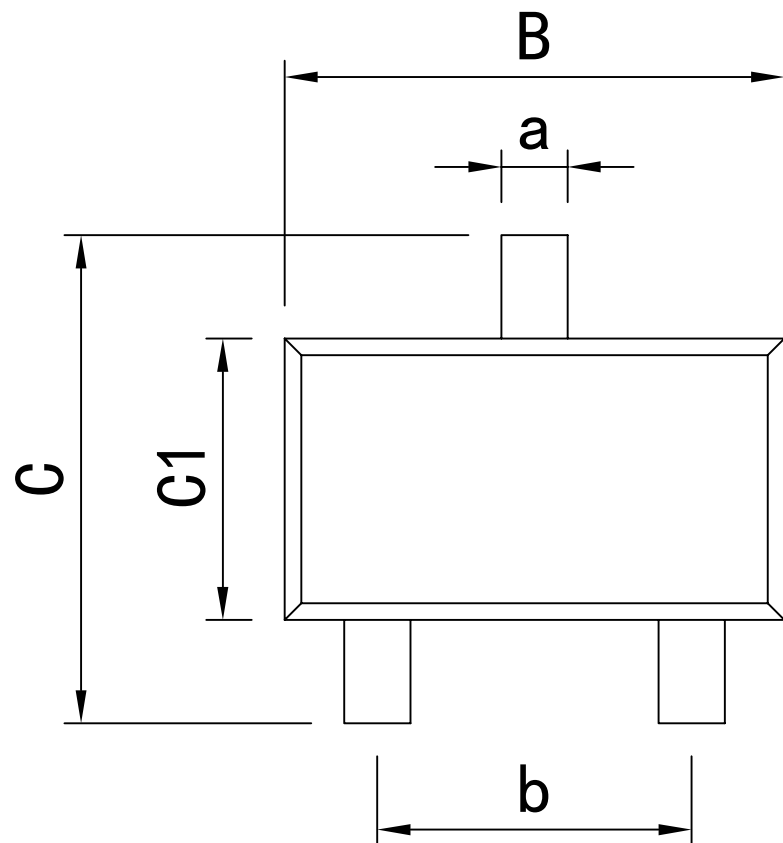




华冠半导体

广东华冠半导体有限公司  
Guangdong Huaguan Semiconductor Co., Ltd.



制图	赖谊成
审阅	罗云龙
核准	林钟涛

**SOT23-3**

文件名称:  
HG-SOT23-3

文件编号:  
HGWXT-230058

版本	VI.0
比例	1:1
单位	mm
日期	2023-7-11

图纸幅面 A4



第一角法

UNITT : mm

DIM.	A	A1	B	C	C1	D	Q	a	b			
MIN	1.00	0.00	2.82	2.65	1.50	0.30	0°	0.30	1.90			
MAX	1.15	0.15	3.02	2.95	1.70	0.60	8°	0.50	BSC			